****

|  |  |
| --- | --- |
| **Leserkontakt:** | **Pressekontakt:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network** |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Telefon: +49-991-2700-0 | Telefon: +49-2405-4526720 |
| [info@congatec.com](mailto:info@congatec.com)  [www.congatec.com](http://www.congatec.com) | [info@sams-network.com](mailto:info@sams-network.com)  [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |



*Text und Foto verfügbar:* [*https://www.congatec.com/de/congatec/pressemitteilungen.html*](https://www.congatec.com/de/congatec/pressemitteilungen.html)

Pressemitteilung

Embedded World Präsentation von congatec fokussiert das Embedded Edge Computing

**Von High-End- bis hin zu Ultra-Low-Power Edge Servern**

**Deggendorf, 06. Februar 2020 \* \* \*** Zur Embedded World 2020 stellt congatec das gesamte Spektrum der Embedded Edge Computing Logik vor, die von High-End Edge Servern bis hin zu Headless Systemen für Ultra-Low-Power Edge Logik reicht. Schwerpunkte der Präsentationen sind der kommende COM-HPC Standard der PICMG, den congatec mit Christian Eder als Chairman des COM-HPC Subkomitees maßgeblich vorantreibt, sowie das erweiterte SMARC Ökosystem für die NXP i.MX8 Familie, welches congatec unter anderem für den nahtlosen Einsatz von MIPI Kameratechnologie und Künstlicher Intelligenz ausgelegt hat. Ein neues Starter-Kit für Echtzeit-Workload-Konsolidierung sowie Präsentationen von Basler und Hacarus unterstreichen das breite Spektrum. Abgerundet wird die Produktpräsentation am congatec Stand durch innovative Kühllösungen für robuste Embedded Server und Systeme, die bis zu 100 Watt TDP lüfterlos abführen können.

„Die Innovationen rund um COM-HPC sind extrem wichtig, da sie einen neuen Standard für Edge Server begründen und den Erfolg von COM Express um neue Applikationsfelder erweitern. Deshalb nehmen sie einen bedeutenden Platz in unserer Präsentation ein“, erklärt Martin Danzer, Director Product Management bei congatec. „Entscheidend ist aber auch die Tatsache, dass congatec die gesamte Bandbreite der Embedded Edge Logik abdeckt, von High-End Edge Servern bis hin zur tief eingebetteten Ultra-Low-Power Edge Logic auf Basis von ARM Prozessoren. Für all diese Plattformen bieten wir umfassenden Hard- und Firmwaresupport für OEMs für bestmögliche Konnektivität, höchste Sicherheit und komfortabelste Fernwartbarkeit zusammen mit Vision- und KI-Integration, die in vielen Edge Devices zunehmend an Bedeutung gewinnt. Durch diese sehr hardwarenahen Zusatzdienste bieten wir unseren Kunden weit mehr als nur einen simplen Interfaces Support. Sie erhalten bei uns bedarfsgerechte Lösungsplattformen, die zielgenau den Kundenbedarf für die möglichst einfache Integration ihrer Embedded Edge Computer treffen“.

Die Präsentationen rund um COM-HPC zeigen das bereits veröffentlichte Pinout des kommenden Standards, heben die unterschiedlichen Formfaktoren hervor, die es jeweils in verschiedenen Ausprägungen für Embedded Edge Server und Embedded Clients gibt. Die Edge-Server gibt es in zwei Footprint-Varianten, die bis zu 64 PCIe Lanes sowie 8-fach 25 GbE und bis zu 8 DIMM-Sockel für 1 TByte Arbeitsspeicher bieten. Die kleineren COM-HPC Client-Module gibt es in drei verschiedenen Footprints. Sie führen vier Videoschnittstellen und zwei Kameraeingänge aus und bieten bis zu 4 SODIMM-Sockel.

Bei den Präsentationen der SMARC und Qseven Ökosysteme rund um die extrem energiesparende und variantenreiche NXP i.MX8 Prozessorfamilie zeigt congatec insbesondere innovative Lösungsplattformen in Bezug auf Vision und KI und einfachste WiFi-Implementierungen. Sie alle erleichtern es den Kunden, die neuen Prozessoren vom i.MX 8X über den i.MX 8M Mini bis zum i.MX8 zu integrieren. Für den sofortigen Design Start stellt congatec über Git-Hub individuell kompilierte Binaries zur Verfügung, mit denen Entwickler ihre Plattform direkt booten können.

Mit dem neuen Intel RFP Ready Kit für Echtzeit-Workload-Konsolidierung, das congatec in Kooperation mit Intel und Real-Time Systems zusammengestellt hat, können OEMs direkt einsteigen in die Entwicklung der nächsten Generation von visionbasierter kollaborativer Robotik, Automatisierungssteuerungen und autonomen Fahrzeugen, die mehrere Tasks parallel bewältigen müssen – einschließlich Situational Awareness mittels Deep-Learning basierter KI-Algorithmen. Das bestellfertige RFP Ready Kit nutzt den RTS Hypervisor von Real-Time Systems auf der COM Express Type 6 basierten Intel® Xeon® E2 Serverplattform für industrielle Anwendungen von congatec und bietet alles, was Entwickler benötigen.

Zusammen mit Basler und Hacarus präsentiert congatec auch fertige Development-Kits für Vision und KI. Das MIPI-CSI 2 Smart Camera Kit für Vision-Systeme am Edge fasst alle Hardware- und Software-Komponenten zusammen, die OEMs für die Entwicklung Embedded Vision basierter Applikationen benötigen. Ein besonderes Highlight ist das SMARC Carrierboard, an das MIPI Kameras von Basler direkt über Flatfoil-Konnektoren angebunden werden.

Mit dem in Kooperation mit Hacarus angebotenen KI-Development-Kit können Entwickler direkt die Vorteile von Sparse Modeling basierter KI evaluieren. Das Kit integriert dazu ein KI-System auf Basis der hochskalierbaren und leistungsfähigen congatec Qseven Module mit Intel 'Apollo Lake' Prozessoren, die durch Sparse Modeling erstmals auch KI-Trainingsaufgaben am Edge neben Inferenzalgorithmen ausführen können. Das eröffnet den Machine-Learning Applikationen völlig neue Einsatzbereiche.

Innovative Kühllösungen für die Entwicklung extrem performanter Edge Server, die für den Einsatz im rauen Umfeld abseits wohlklimatisierter Rechenzentren ausgelegt sind, runden die Präsentationen am congatec Messestand ab. Erst mit dieser leistungsfähigen Kühlung können Anwender die Vorteile einer vollen Performance der 16 Core COM Express Type 7 Module mit 3 GHz Dual-Die AMD EPYC Embedded 3000 Prozessoren ausnutzen.

Mit diesem breiten Spektrum von Low-Power bis High-End und von Modulen bis vollständigen Development-Kits lohnt sich für alle Anwendergruppen ein Besuch am congatec Stand. Besuchen Sie congatec also auf der Embedded World in Halle 1, Stand 358.

Weitere Informationen zu den Präsentationen von congatec auf der Embedded World finden Sie unter: <https://www.congatec.com/ew2020>

**Über congatec**

congatec ist ein stark wachsendes Technologieunternehmen mit Fokus auf Embedded-Computing-Produkten. Die leistungsstarken Computermodule werden in einer Vielzahl von Systemanwendungen und Geräten in der industriellen Automatisierung, der Medizintechnik, dem Transportwesen, der Telekommunikation und vielen anderen Branchen eingesetzt. Im Segment Computer-on-Module ist congatec globaler Marktführer mit einer exzellenten Kundenbasis von Start-ups bis zu internationalen Blue-Chip-Unternehmen. Das 2004 gegründete Unternehmen mit Sitz in Deggendorf erwirtschaftete 2018 einen Umsatz in Höhe von 133 Mio. US Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter [www.congatec.de](http://www.congatec.de/) oder bei [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/455449), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) und [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*